

The FerroTec logo is displayed in a light blue, semi-transparent style. Below it, a list of product types is shown in a smaller, light blue font: THERMOELECTRIC MODULE, COMPUTER SEAL, VACUUM FEEDTHROUGH, QUARTZ, and CMS (Contract Manufacture).A background image showing various industrial components, including cylindrical metal parts and seals, arranged in a cluster. The image is semi-transparent and serves as a backdrop for the text.

株式会社フェローテックホールディングス 2018年3月期決算説明会資料

2018年5月28日

(ジャスダック6890)

<http://www.ferrotec.co.jp/>

1. 当期連結決算においては、フェローテックは2017年4月～2018年3月末の業績を、それ以外の連結子会社・持分法適用会社は2017年1月～12月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2018年3月期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は2018年5月28日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。



2018年3月期業績報告

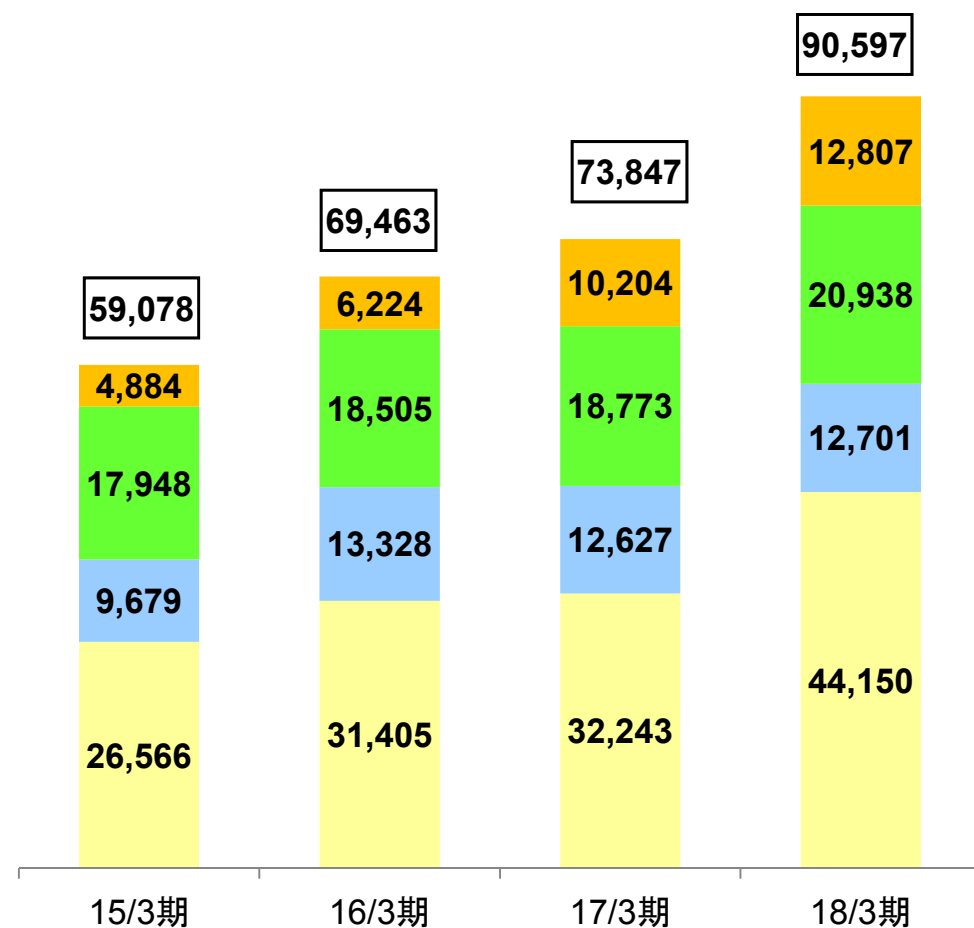
業績推移



売上高の推移

(百万円)

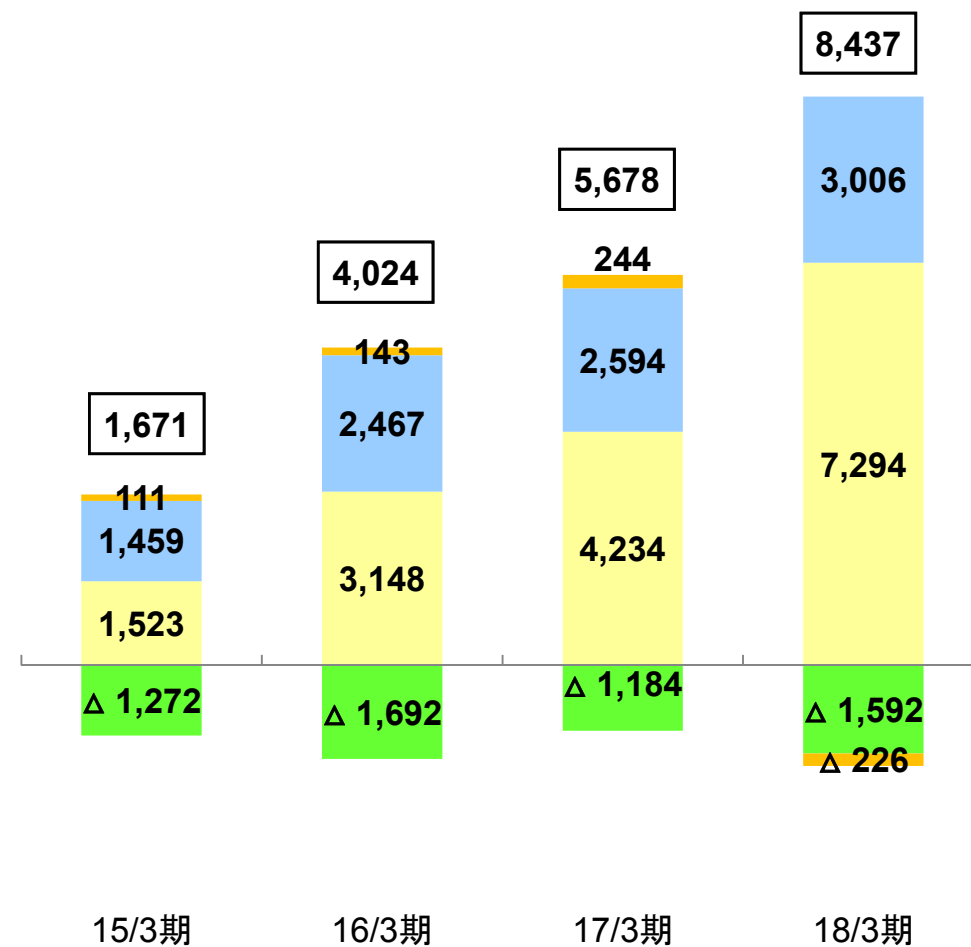
■ 半導体等装置関連 ■ 電子デバイス ■ 太陽電池 ■ その他



営業利益の推移

(百万円)

■ 半導体等装置関連 ■ 電子デバイス ■ 太陽電池 ■ その他



連結決算サマリー



百万円	2017年3月期		2018年3月期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	増減率(%)
売上高	73,847	100.0	90,597	100.0	16,750	22.7
売上原価	54,139	73.3	65,682	72.5	11,543	21.3
売上総利益	19,708	26.7	24,915	27.5	5,207	26.4
販売管理費	14,030	19.0	16,477	18.2	2,447	17.4
営業利益	5,678	7.7	8,437	9.3	2,759	48.6
営業外収益	862	1.2	669	0.7	△ 193	△ 22.4
営業外費用	864	1.2	1,948	2.2	1,084	125.5
経常利益	5,675	7.7	7,157	7.9	1,482	26.1
特別利益	170	0.2	122	0.1	△ 48	△ 28.2
特別損失	731	1.0	1,779	2.0	1,048	143.4
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,256	4.4	2,678	3.0	△ 578	△ 17.8
設備投資額	7,322	-	12,300	-	4,978	68.0
減価償却費	3,593	-	4,188	-	595	16.6

連結決算サマリー



百万円	2018年3月期	
	金額	売上比(%)
売上高	90,597	100.0
売上原価	65,682	72.5
売上総利益	24,915	27.5
販売管理費	16,477	18.2
営業利益	8,437	9.3
営業外収益	669	0.7
営業外費用	1,948	2.2
経常利益	7,157	7.9
特別利益	122	0.1
特別損失	1,779	2.0
税前利益	5,501	6.1
法人税等合計	2,815	3.1
親会社株主に帰属する当期純利益	2,678	3.0

主に半導体等装置セグメントの売上増によりPV事業での滞留棚卸資産の処分を吸収し売上総利益率は前年26.7%より27.5%に改善

売上高増加に伴い、前年度比2,447百万円増加だが、売上高販管比率は前年の19.0%より18.2%に改善

持分法投資利益 328百万円
為替差損 640百万円

PV事業に係る訴訟案件に対する引当金繰入1,114百万円を計上、上訴し受理されているが保守的に計上

セグメント別売上高および営業利益



売上高 (単位:百万円)	2017年3月期		2018年3月期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半導体等装置関連	32,243	43.7	44,150	48.7	11,907	36.9
電子デバイス	12,627	17.1	12,701	14.0	74	0.6
太陽電池	18,773	25.4	20,938	23.1	2,165	11.5
その他	10,204	13.8	12,807	14.1	2,603	25.5
合計	73,847	100.0	90,597	100.0	16,750	22.7

営業利益 (単位:百万円)	2017年3月期		2018年3月期		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半導体等装置関連	4,234	13.1	7,294	16.5	3,060	72.3
電子デバイス	2,594	20.5	3,006	23.7	412	15.9
太陽電池	△1,184	-	△1,592	-	△408	-
その他	244	2.4	△226	-	△470	-
全社消去	△210	-	△44	-	166	-
合計	5,678	7.7	8,437	9.3	2,759	48.6

連結貸借対照表 ～資産～



(百万円)	2017/3期 期末	2018/3期 期末	増減額
流動資産	51,245	67,240	15,995
現金及び預金	14,778	23,648	8,870
受取手形及び売掛金	17,656	20,700	3,044
たな卸資産	13,883	16,773	2,890
固定資産	40,855	51,217	10,362
有形固定資産	34,294	43,541	9,247
建物及び構築物	8,583	10,355	1,772
機械装置及び運搬具	8,454	12,564	4,110
工具、器具及び備品	5,908	7,304	1,396
土地	1,280	1,589	309
無形固定資産	2,060	2,922	862
のれん	769	378	△ 391
投資その他資産	4,499	4,753	254
資産合計	92,100	118,457	26,357

【流動資産の主な増加要因】
株式の発行による現金・預金の増、売上増に伴う売上債権の増、受注好調によるたな卸資産の増等による

【有形固定資産の主な増加要因】
8インチウエーハ用設備、セラミクス・クォーツの増産対応設備等により増加(建設仮勘定1,754百万円増加含む)

【無形固定資産の状況】
のれん償却額: 392百万円(うち185百万円(株)アサヒ製作所分一時償却)
杭州市に設立の8inch子会社が土地使用権(無形固定資産の「その他」)1,260百万円取得

連結貸借対照表 ～負債及び純資産～



(百万円)	2017/3期 期末	2018/3期 期末	増減額
流動負債	32,108	43,481	11,373
支払手形及び買掛金	13,926	18,419	4,493
短期借入金	5,002	5,874	872
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	4,538	5,643	1,105
固定負債	20,290	23,163	2,873
長期借入金・社債	12,625	13,896	1,271
負債合計	52,399	66,645	14,246
純資産	39,701	51,812	12,111
株主資本	33,208	43,855	10,647
その他の包括利益累計額	6,015	7,449	1,434
非支配株主持分	453	502	49
負債・純資産合計	92,100	118,457	26,357

【流動負債増加の主な要因】

半導体等装置関連事業の好調による売上増に伴う仕入債務の増加及び設備未払金の増加による

【有利子負債の状況】 ()内は17/3期末時点の数値

短期借入+1年内長借+1年内社債	11,518 百万円	(9,541)
長期借入+社債	13,896 百万円	(12,625)
合計	25,414 百万円	(22,166)
【ネット有利子負債	1,766 百万円	(7,388)】

【純資産項目】

純資産の主な変動内訳:

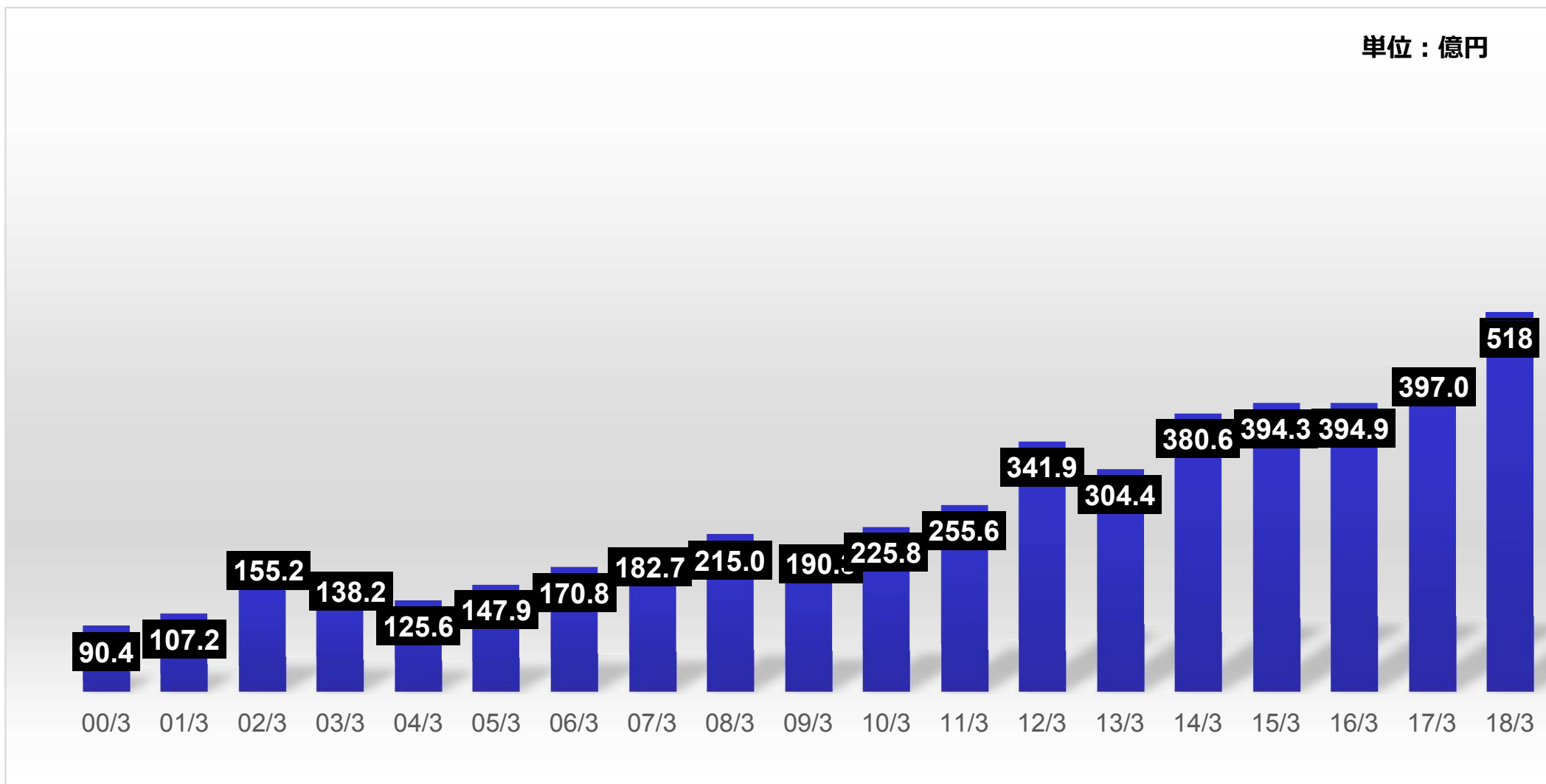
新株発行	: 8,784百万円
当期純利益	: 2,678百万円
配当金	: △ 812百万円
為替換算調整勘定	: 1,375百万円

※当期純利益=親会社に帰属する当期純利益

連結純資産推移



単位：億円



キャッシュフロー計算書



(百万円)	2017/3期	2018/3期
営業活動によるキャッシュフロー	8,218	9,946
税引前当期純利益	5,114	5,501
減価償却費	3,593	4,188
為替差損益(△:益)	401	△134
売上債権の増減(△:増加)	△1,025	△2,435
たな卸資産の増減(△:増加)	666	△2,604
仕入債務の増減(△:減少)	2,603	3,931
その他	△3,135	1,499
投資活動によるキャッシュフロー	△7,070	△12,388
有形固定資産取得による支出	△7,322	△11,087
有形固定資産の売却による収入	69	116
無形固定資産の取得による支出	△7	△1,212
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	387	-
その他	△197	△204
財務活動によるキャッシュフロー	3,897	10,830
短期借入金の増減額	△1,616	728
長期借入れによる収入	9,933	4,148
長期借入金の返済による支出	△3,813	△4,786
社債の発行による収入	0	3,245
株式の発行による収入	19	8,712
その他	△625	△1,218
現金及び現金同等物の増加額	4,739	8,810
現金及び現金同等物の期首残高	10,038	14,778
現金及び現金同等物の期末残高	14,778	23,648

【営業CFの状況】

税前利益+減価償却:
 9,689百万円
 売上債権増加による営業CFの減少:
 △2,435百万円
 仕入債務減少による営業CFの増加:
 3,931百万円

【投資CFの状況】

有形・無形固定資産取得支出の主な内容
 ・上海子会社: 3,485百万円
 ・杭州子会社: 5,298百万円
 ・銀川子会社: 1,400百万円

(百万円)	2018/3期	2019/3期(計)	前期比(%)
売上高	90,597	98,000	8.2
営業利益	8,437	9,800	16.2
経常利益	7,157	8,500	18.8
親会社に帰属する 当期純利益	2,678	5,300	97.9
設備投資額	12,300	40,000	-
減価償却費	4,188	5,000	-

注 為替レート2018/3期→2019/3期予想レート：米ドル112.04円→105.00円 人民元 16.63円→16.00円(期中平均レート)

設備投資は、前期設備未払金を考慮したCFベースの数値です。

通期業績見通し



(百万円)	2019/3期 予想
売上高	98,000
営業利益	9,800
経常利益	8,500
親会社 に 帰属 する 当期 純利益	5,300

半導体業界の大口顧客から増産要請が強いマテリアル製品に関し、セラミックス製品、石英製品の製造工場を増強または新設により増収を見込む。

半導体等装置関連事業ならびに電子デバイス事業の収益は安定的、太陽電池関連事業の整理も一段落したため、増益を見込む。

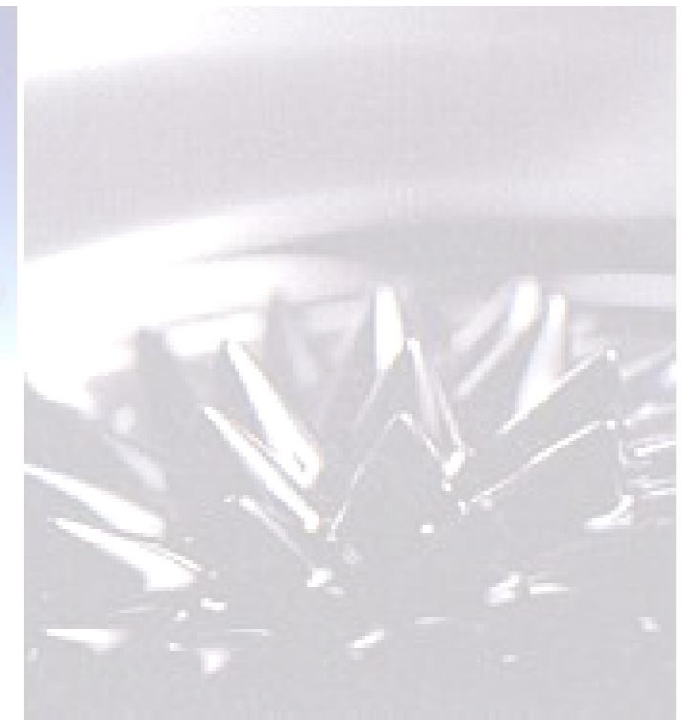
為替感応度はドル円で1円/年間、売上高950百万円程、営業利益65百万円程の影響額、支払利息は700百万円と想定

実行税率は37%前後を見込む。

通期業績見通し(セグメント別売上高)

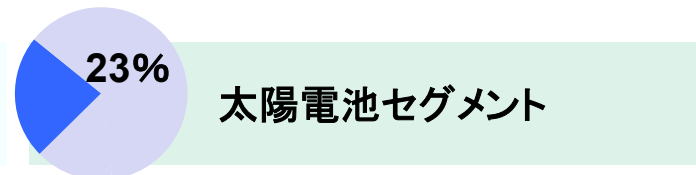
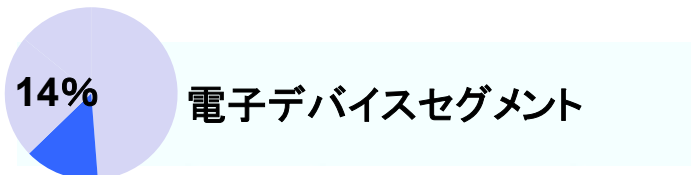
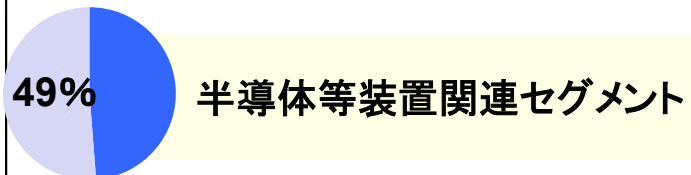


(百万円)	2018/3期	2019/3期(計)	前期比 (%)
半 導 体 等 装 置 関 連	44,150	58,710	33.0
真空シール	11,761	15,000	27.5
石英製品	11,523	13,640	18.4
セラミックス	8,729	11,500	31.7
CVD-SiC	3,039	3,000	△ 1.3
EBガン・LED蒸着装置	3,936	4,270	8.5
ウエーハ加工	5,161	7,500	45.3
部品洗浄	-	3,800	-
電 子 デ バ イ ス	12,701	12,930	1.8
サーモモジュール	11,634	11,880	2.1
磁性流体・その他	1,068	1,050	△ 1.7
太 陽 電 池	20,938	16,207	△ 22.6
石英坩堝	1,850	2,000	8.1
太陽電池用シリコン	13,066	8,317	△ 36.3
シリコン結晶製造装置	157	120	△ 23.6
セル・その他	5,865	5,770	△ 1.6
そ の 他	12,807	10,153	△ 20.7
合 計	90,597	98,000	8.2



2018年3月期業績報告

セグメント別の状況と今後の見通し



真空シール



石英製品



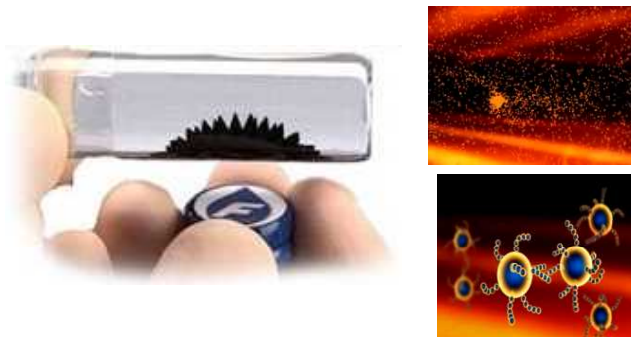
セラミックス製品



CVD-SiC



磁性流体



サーモモジュール



パワー半導体用基板



太陽電池用シリコン(OEM)

単結晶



多結晶



PV用ウエーハ



PV用セル



125 R150



125 R165



156 R200

消耗品群

石英坩堝



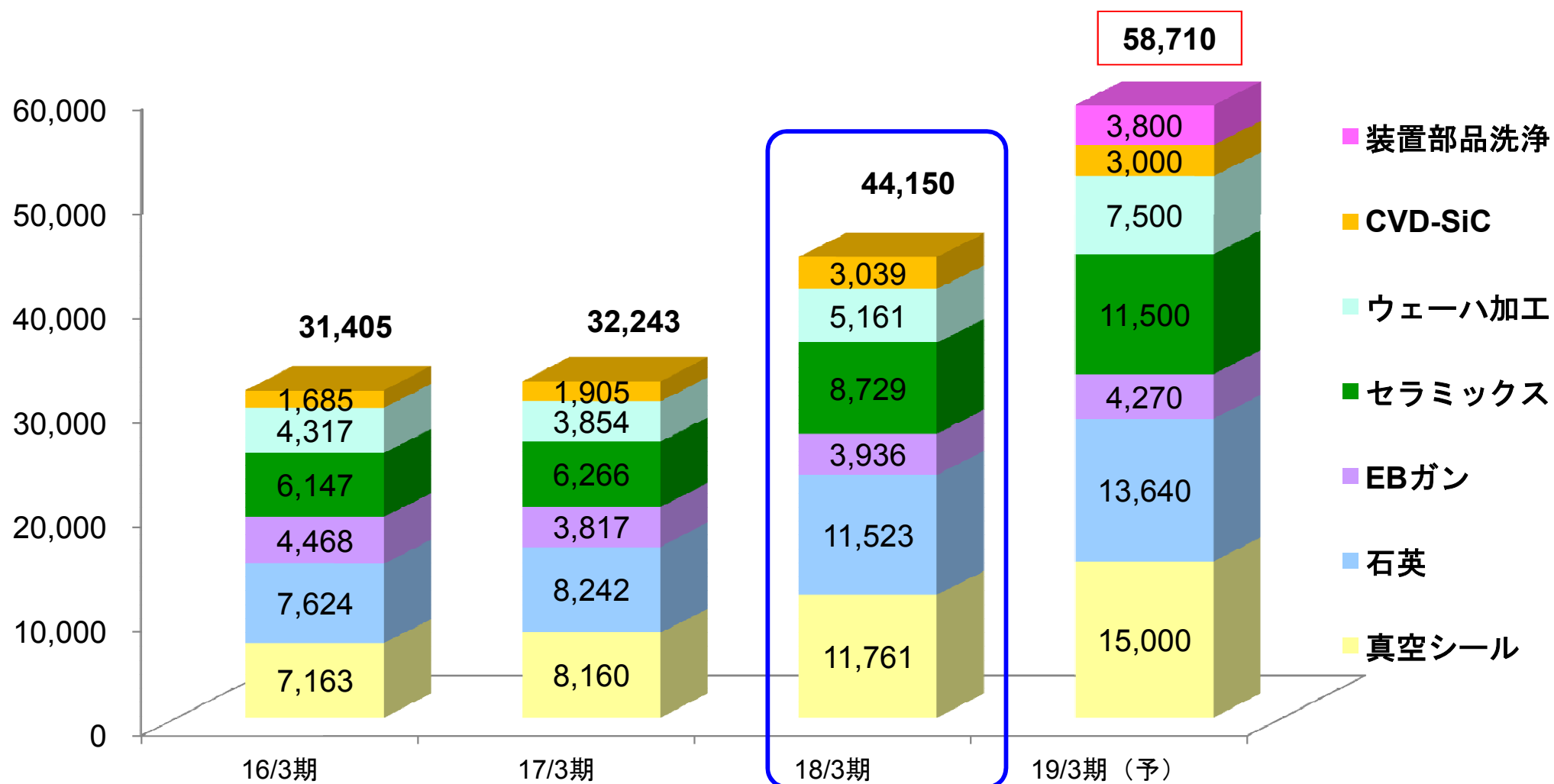
角槽坩堝



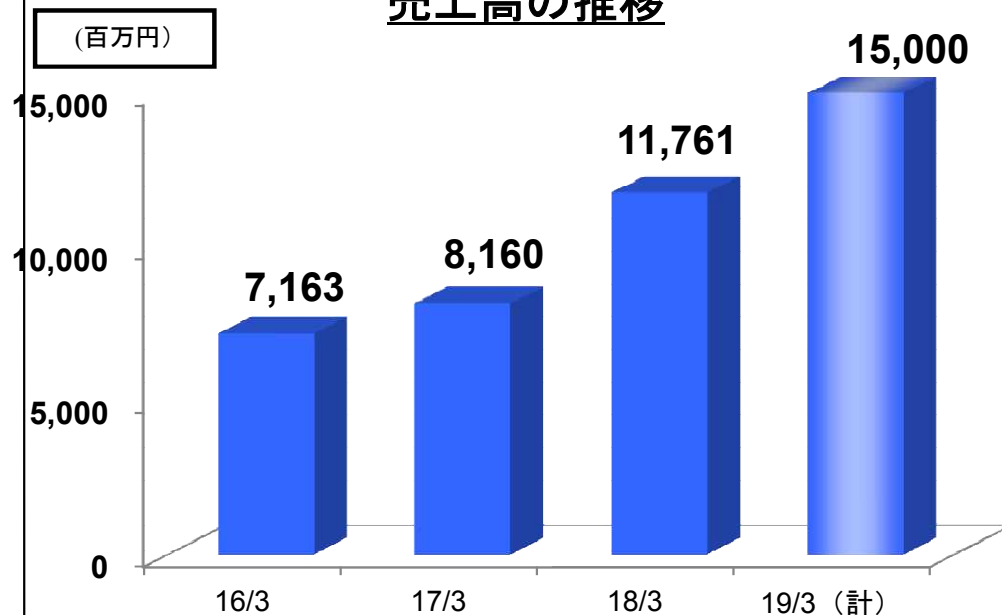
半導体等装置関連セグメント



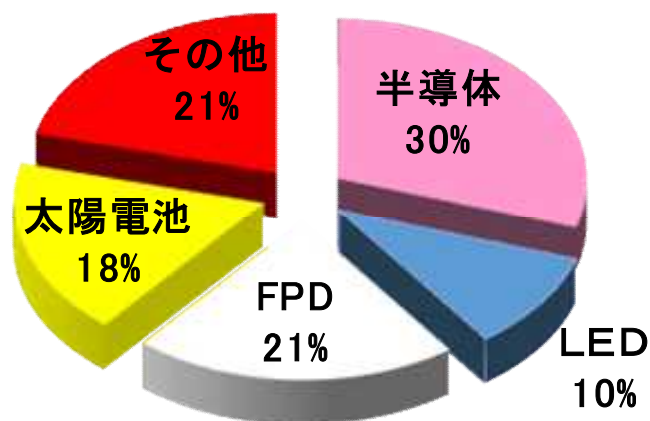
売上高
(百万円)



売上高の推移



真空シール関連事業の販売先業種別シェア



注) その他: 産業用真空装置、航空、医療、科学など

1. 18/3期の業績

- ・ 半導体製造装置真空プロセス向け需要拡大継続
- ・ FPD市場における有機EL需要は中国パネルメーカーの投資により堅調であった
- ・ 欧米・中国市場より、受託加工に対するニーズが増加

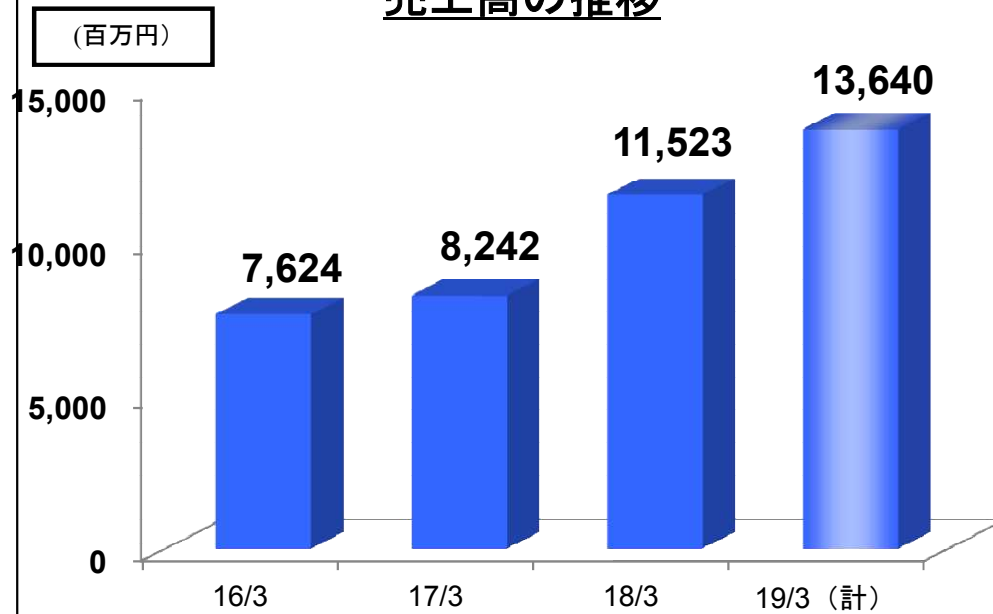
2. 19/3期の見通し

- ・ 引き続き、半導体製造装置真空プロセス向け需要が旺盛に推移する見通し
- ・ FPD市場における有機EL需要は大手パネルメーカーの投資延期影響があり、下期より若干調整が入る
- ・ 中国市場を中心に、受託加工の需要は一段と強く推移する見通し

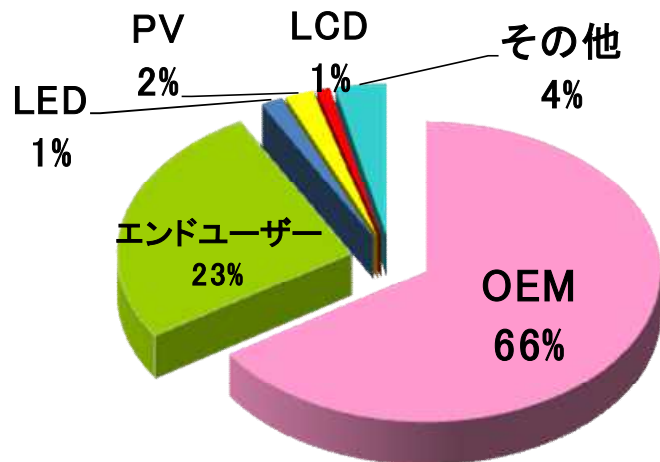
《施策》

- ・ 半導体製造装置メーカーとの共同開発を継続
- ・ 大型加工機の設備投資継続
- ・ 当社グループ間の関係を強化しシナジー獲得
- ・ アジア圏での営業強化

売上高の推移



石英製品の販売先業種別シェア



1. 18/3期の業績

- 半導体の需要拡大により、過去最高売上を計上
- 国内大手OEMの次世代対応品の増加により売上拡大
- 米国大手OEMの好調とシェア拡大により売上拡大
- 台湾DRAMメーカーの受注増加により売上が上昇
- 国内大手OEM向けにSiエッチャーパーツの供給を開始

2. 19/3期の見通し

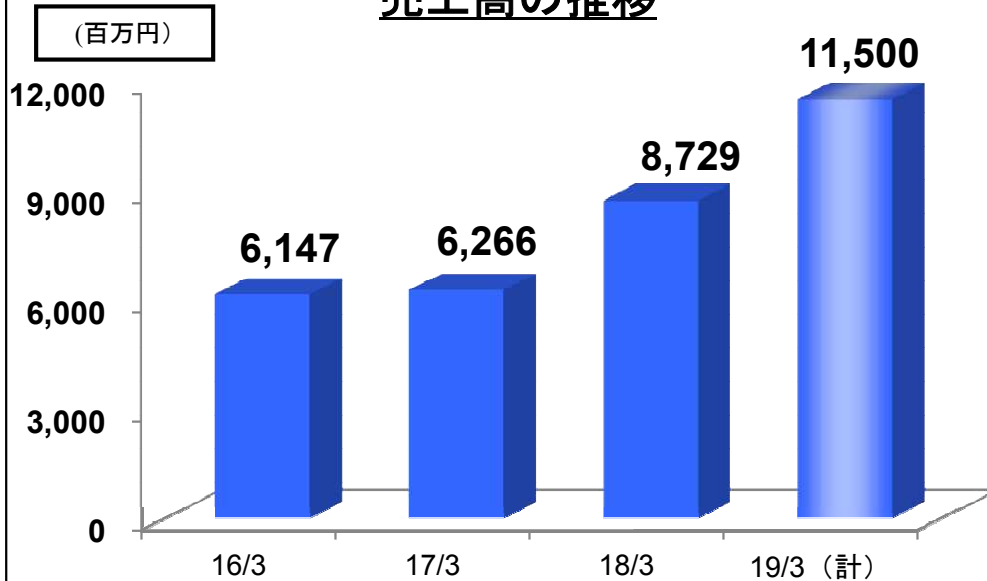
- 2019年3期の半導体投資は旺盛なメモリー投資需要があり、石英製品の供給を上回る需要あり
- メモリー系(D-RAM, 3D-NAND)、IOT、パワー半導体、車載向け投資が旺盛。また中国FABの本格投資により、デバイスメーカーからの石英スペアパーツ需要が増加する見通し
- 国内大手OEMも増産対応で石英製品需要拡大見通し
- 米国大手OEMの需要倍増で増加傾向
- 国内大手OEMへのSiパーツ供給量を開始、拡大の見通し

《施策》

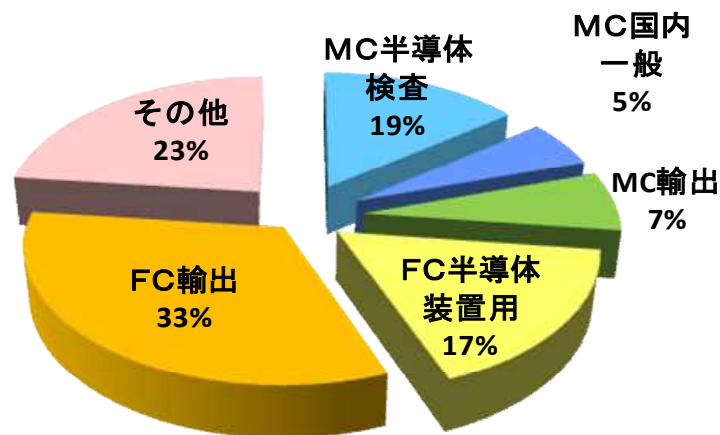
- 大手OEM需要増にて、増産体制実施。中国に新工場建設 (中国 常山工場、東台工場 2拠点新工場着工)
- 次世代、次々世代用の開発案件の取組み強化。(国内に開発拠点、次世代開発製品の工場 2019年1月稼働予定)

セラミックス製品の状況と今後の見通し

売上高の推移



セラミックス製品の製品別販売シェア



注)FC:ファイン・セラミックス MC:マシナブル・セラミックス(ホトベール)

1. 18/3期 (1-12月)の業績

マシナブルセラミックス “ホトベール”

- ・ 国内半導体logic向け用検査治具が好調
- ・ 国内一般産機用は堅調、海外医療品は好調

ファインセラミックス

- ・ 国内は半導体成膜装置・FPD装置部品の需要が増加
- ・ 海外エッチング装置向け部品が続伸し記録更新

2. 19/3期 (1-12月)の見通し

マシナブルセラミックス “ホトベール”

- ・ 国内は半導体メモリー用検査治具は低調だが、logic用は好調を予想。
- ・ 国内一般産機用、海外医療関係部品ともに堅調を予想。

ファインセラミックス

- ・ 国内はFPD装置部品の需要は一部低い予想だが、半導体装置部品は好調を見込む
- ・ 海外は成膜装置用、エッチング装置向け部品は更に需要増加し、2017年を超える販売を見込む

3. 継続販売方針

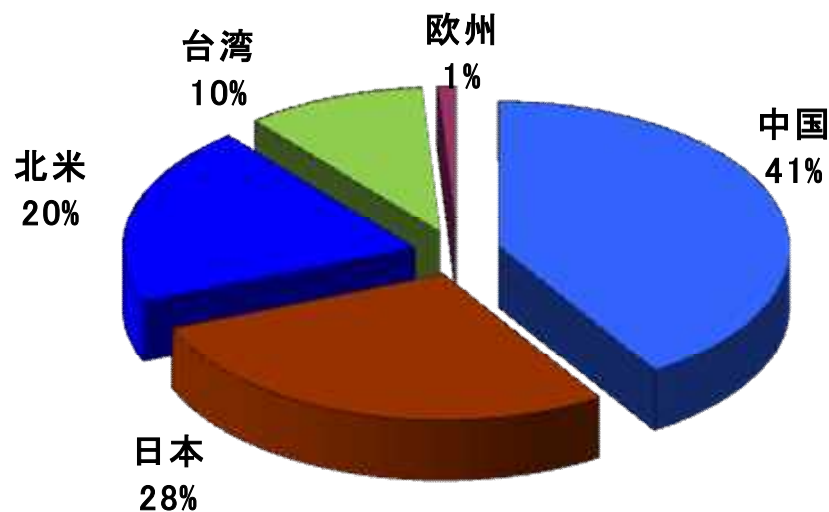
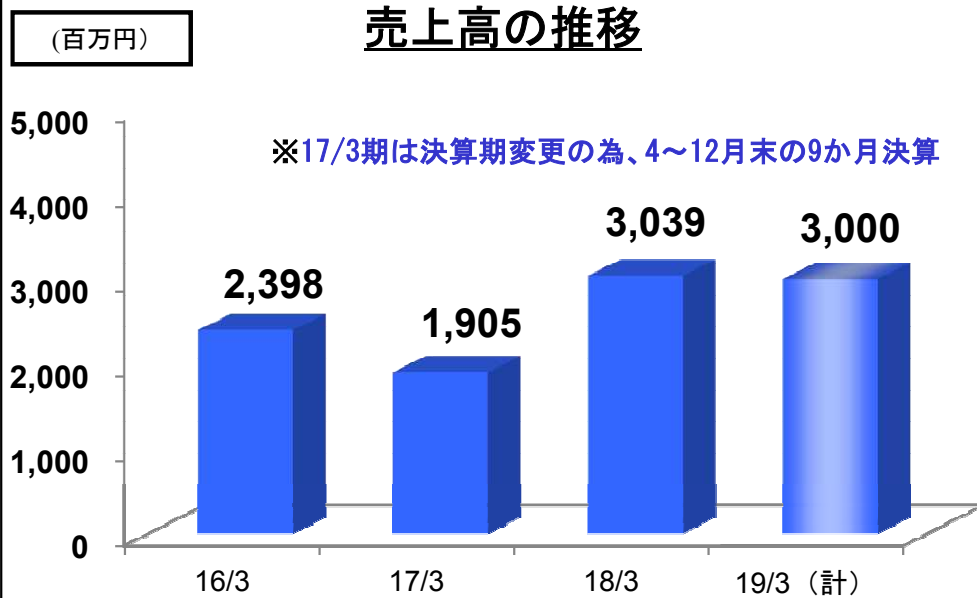
〈マシナブルセラミックス〉

- ・ 車載向けなど高精度、高付加価値製品の拡販に取り組む。従来の製品に加え、耐熱、電気絶縁部品への拡販展開を図る。

〈ファインセラミックス〉

- ・ 世界的な半導体製造装置需要の拡大にともない、2017年は過去最高の生産体制を構築したが、更なる顧客の増産要請に応えるべく、工場の拡張、生産ラインの増強による生産体制強化を図り、昨年を超える販売増加を目指す。

CVD-SiC製品の状況と今後の見通し



CVD-SiC製品の地域別販売シェア

1. 18/3期の業績

- 中国の新規投資に伴う国内・海外の半導体製造装置向け部材は好調
- 新装置部品の積極的試作・開発が奏功し、量産化開始
- 引き続き、大型設備を活用、大型部材への参入加速
- 最先端ニーズに対応し、ニッチ製品も量産化
- 非半導体分野への積極参入

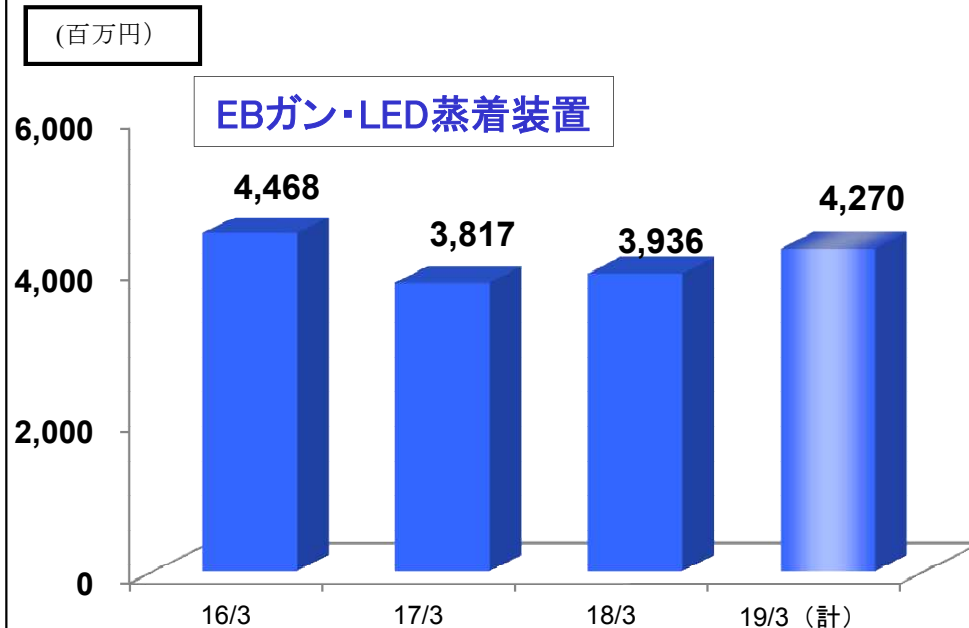
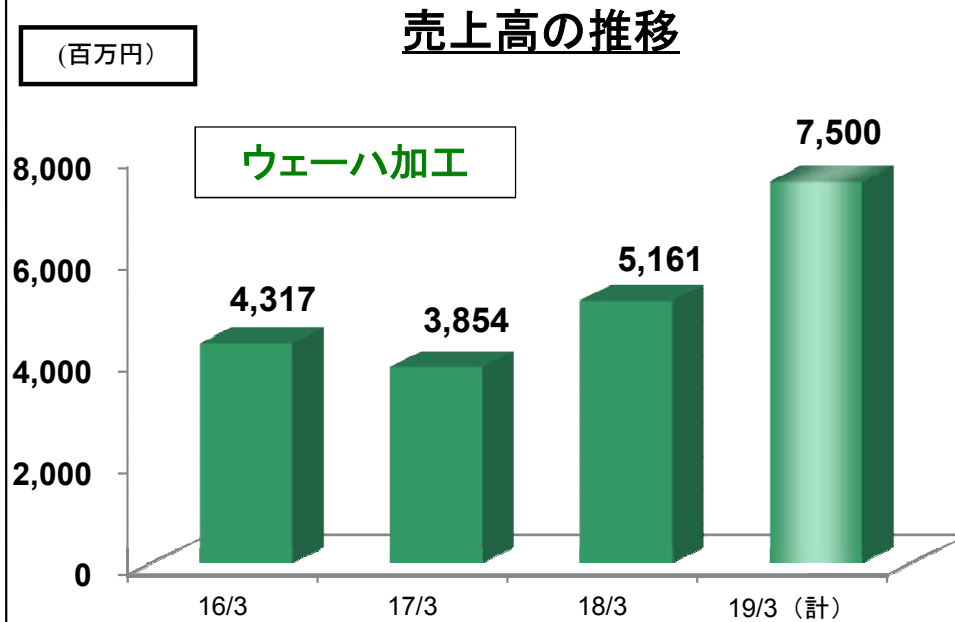
2. 19/3期の見通し

- 中国の新規投資に伴う、国内・海外の半導体製造装置向け部材は好調持続
- 量産済新装置部品は、代替材の採用で一部需要鈍化
- 大型部品は量産化開始
- グループ内向けコーティング製品対応開始

《施策》

- 半導体製造装置メーカーの装置部品の需要増加に対応できる生産体制整備
- 韓国に半導体製造装置部品の製造会社を設立、量産化
- 引き続き非半導体分野への積極参入
- 開発・試作体制の強化

ウェーハ加工と蒸着装置の状況と見通し



半導体ウェーハ:

1. 18/3期の業績

- ・ アナログ、ディスクリート、パワー半導体向け需要旺盛につき、6インチは月産36万枚フル稼働の状況で推移
- ・ 8インチは量産認定用の生産を開始

2. 19/3期の見通し

- ・ 6インチは2018年内に月産40万枚の体制に増産予定
 - ・ 8インチは環境対策で生産停止。6月より生産再開の見通し
- 《施策》

8インチは杭州新工場を建設し、2019年度に稼働開始予定。2020年度中に月産45万枚体制を構築(上海 10万枚含む)

EBガン・蒸着装置:

1. 18/3期の業績

- ・ IoT用途での通信・フィルター向け装置需要伸長
- ・ 5G通信基地局向け各種アプリケーション開発推進

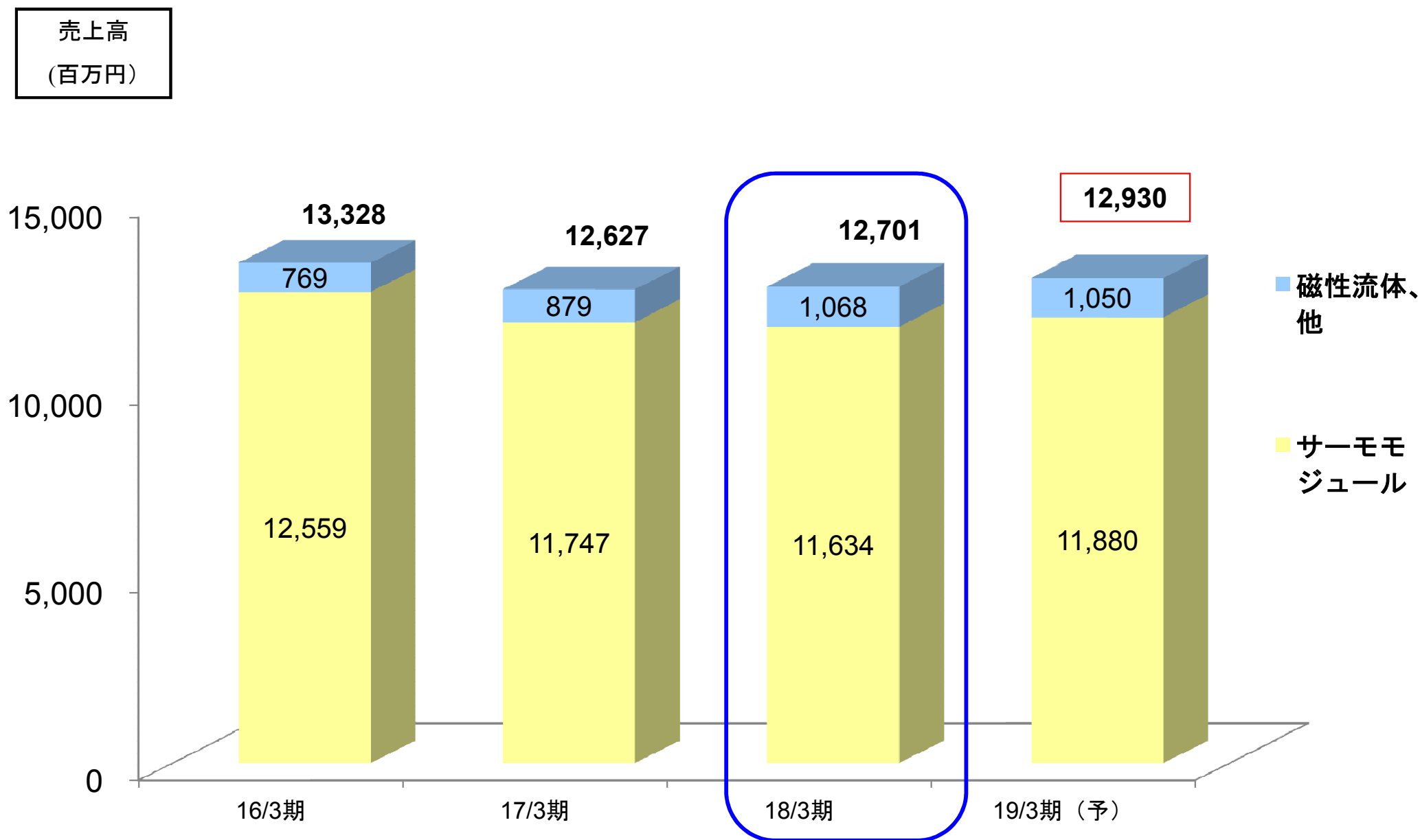
2. 19/3期の見通し

- ・ IoT用途を中心に引き続き通信・フィルター向け需要に対応し、前年対比での増収を見込む

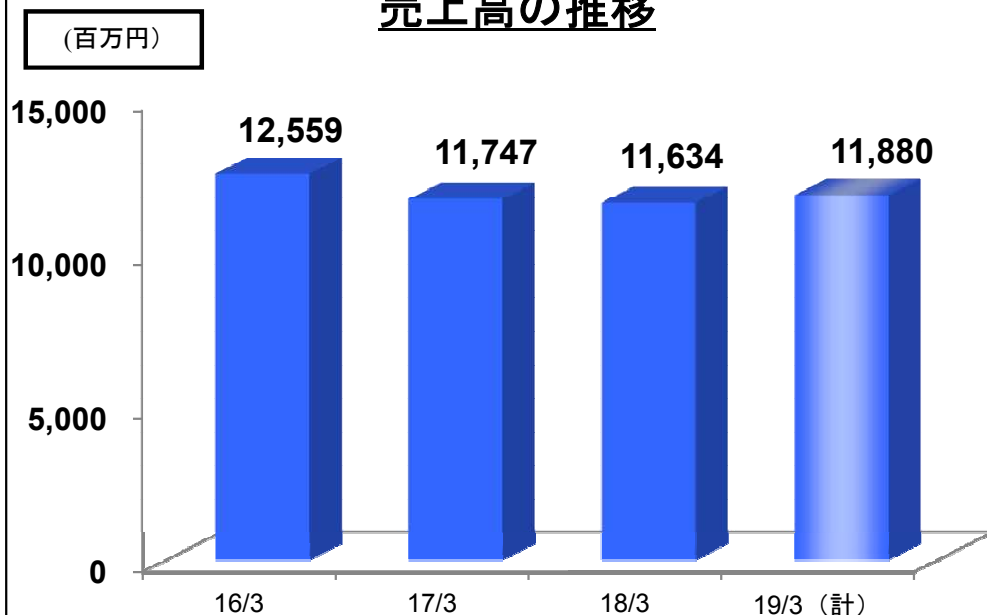
《施策》

- ・ IoTアプリケーション拡充、及び19-20年に本格化予定の5G向け各種アプリケーションへの開発対応強化

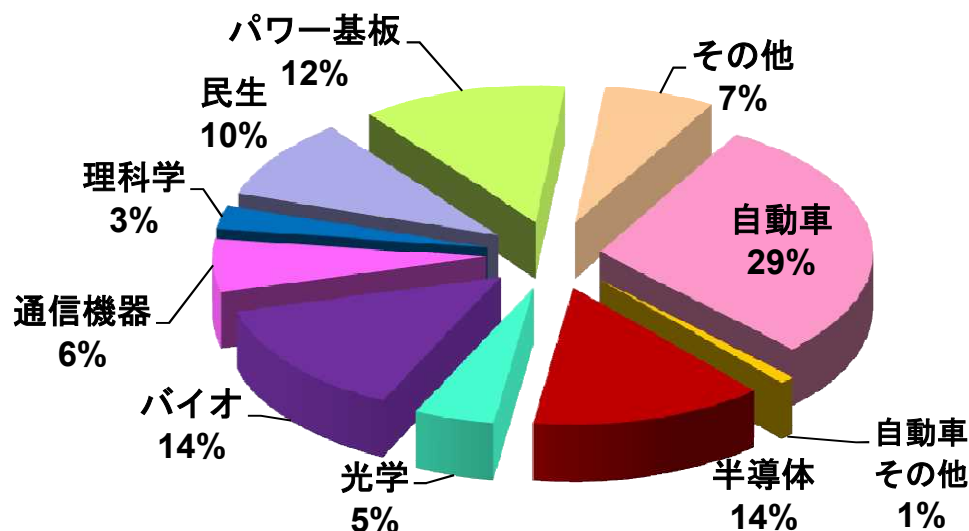
電子デバイスセグメント



売上高の推移



サーモモジュールの業種別販売先シェア



1. 18/3期の業績

自動車温調シート

- ・ 温調シートは中国市場向けの伸長があるものの、米国市場での販売状況に連動しやや軟化
- ・ 今後のEV、自動運転等を睨み、自動車プロジェクトを発足

その他の産業

- ・ 半導体ウェーハの温調用途、バイオ・医療検査向けが拡大
- ・ 産業用、家電用、自動車用のパワー半導体基板が伸長

2. 19/3期の見通し

自動車向け

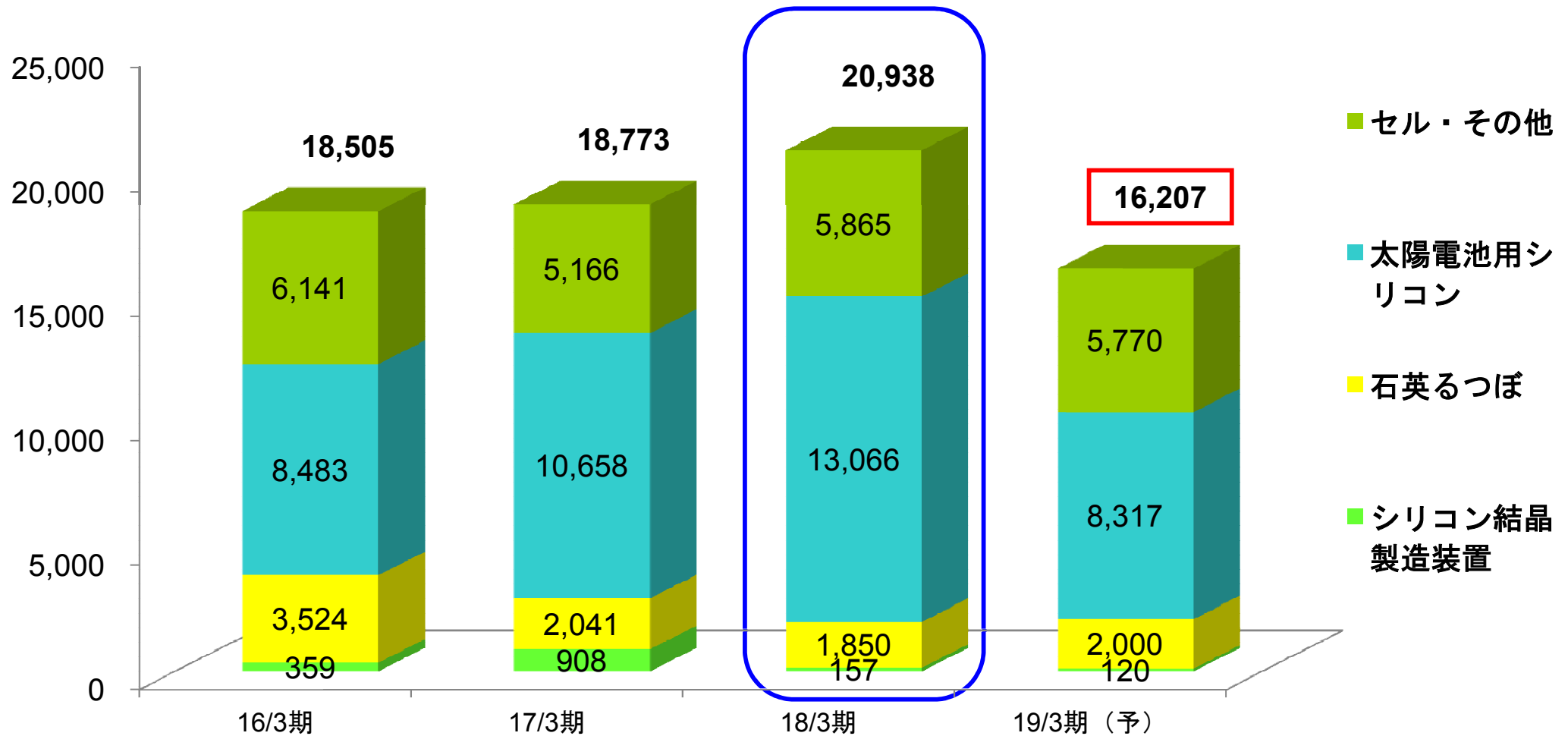
- ・ 温調シートは今期も引き続き軟調の見通し
- ・ ヘッドアップディスプレイ、バッテリー冷却、その他新用途の開拓に注力

その他の産業向け

- ・ 半導体製造装置、バイオ・医療検査装置、民生等は堅調に推移する見通し
- ・ 世界的な消費電力削減のトレンドでパワー半導体基板伸長《施策》
- ・ サブアッシー品を増し、営業強化(半導体・医療)
- ・ 新型モジュール製品・組込製品ラインナップ拡充
- ・ 増産および自動化に対応した設備投資を実施中
- ・ パワー半導体用基板、量産投資を継続実施中

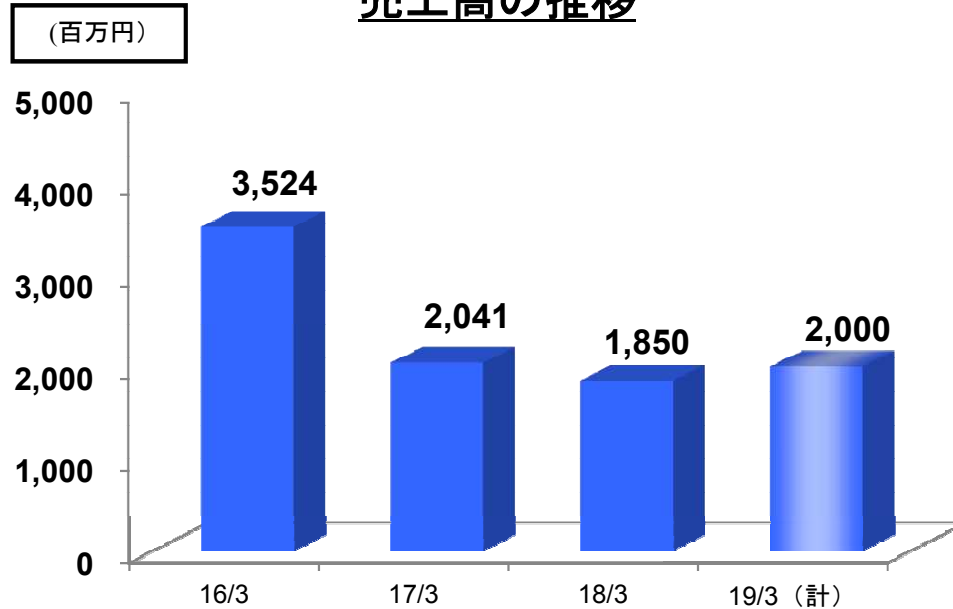
太陽電池セグメント

売上高
(百万円)



坩堝の状況と今後の見通し

売上高の推移



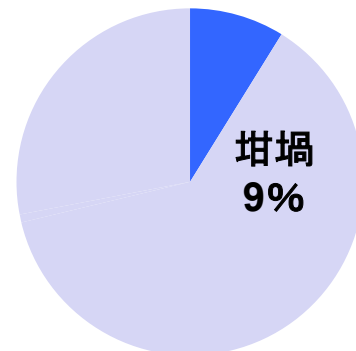
単結晶用石英坩堝



多結晶用角槽は撤退実施

太陽電池セグメントに占める
売上高構成比

2018/3期



1. 18/3期の業績

- 太陽電池向け単結晶坩堝は減少傾向(大幅減少)
- 半導体ルツボについて、需要を背景に単結晶半導体向けは好調
- 不採算の太陽電池向け角槽について生産撤退

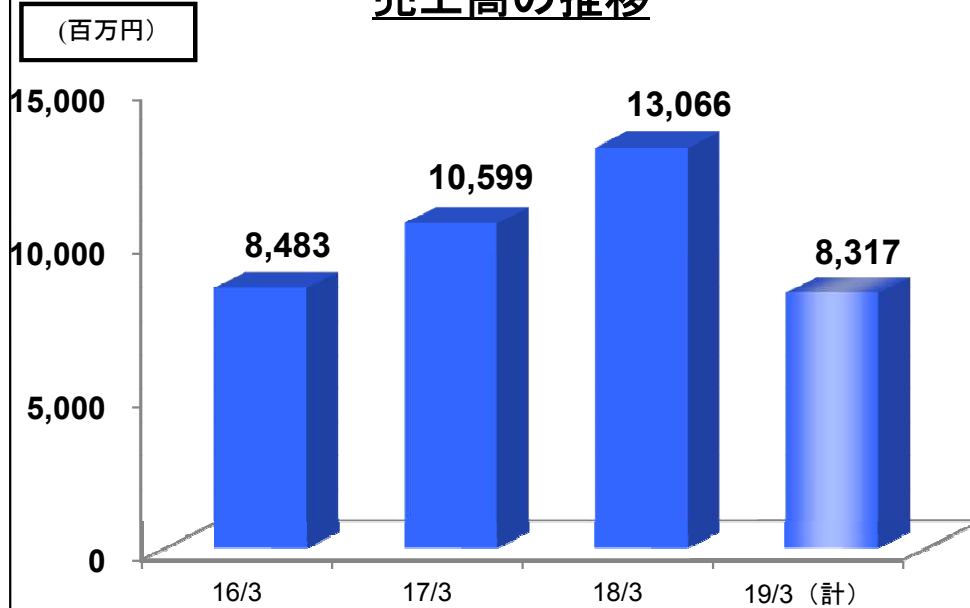
2. 19/3期の見通し

- 半導体向け坩堝の需要増が予測され、単結晶ルツボが増加傾向の見通し
- 中でも半導体中口径坩堝の増加が期待されるが、中国各社立ち上げは遅延傾向
- 太陽電池向け大型坩堝は28インチ大型化に集中、但し、将来的には32インチの可能性も有り

《施策》

- 半導体向けに注力し、半導体ルツボの拡販実施
- 半導体ルツボ専用(クリーン化、自動化後工程)工場(新棟2018年9月完成予定)
- 32インチ大型溶融炉の開発取組み

売上高の推移



1. 18/3期の業績

- 17年末に向けての中国駆け込み需要及び、単結晶N型ウェーハを中心に稼働率を確保し、シリコン製品全体では採算を確保
- 全世界の導入量は年間96GWの実績(前年比26%伸長)となるも、中国大手メーカーの増産と、一時的な需要減少から、18年初よりウェーハ価格が下落

2. 19/3期の見通し

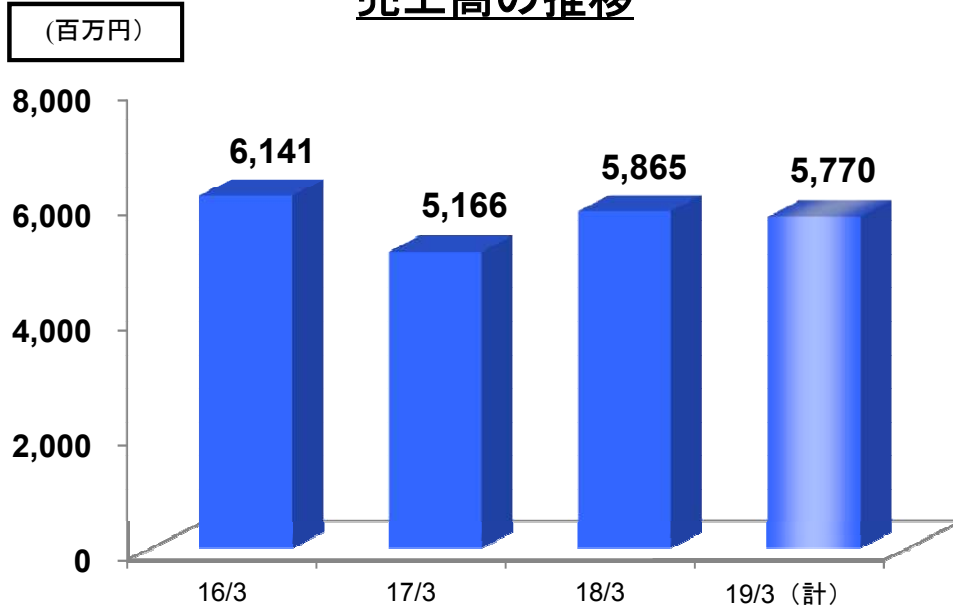
- N型ウェーハは、評価認定の拡大で、増量見込み
- 多結晶はOEMに集中し、稼働・採算の確保を図る
- 2018年度も全世界の導入量は拡大基調となるが、ウェーハ価格の低迷が課題

《施策》

- 固定砥粒でウェーハの細線化をさらに追求
- 低酸素化等 N型単結晶の性能向上で顧客要求対応
- 高付加価値品への集中
- 太陽電池事業は構造改革を継続し、事業の抜本的改善に取り組む

太陽電池用セルの状況と今後の見通し

売上高の推移

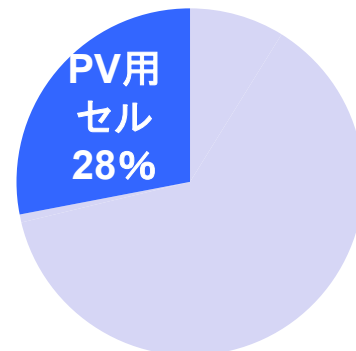


PV用セル

太陽電池セグメントに占める

売上高構成比

2018/3期



1. 18/3期の業績

- 単結晶、多結晶何れも価格下落基調となり、年後半はやや軟調に推移
- PERC単結晶セルの市場での競争環境が高まる傾向になり、効率向上で価格競争力維持に取り組む







2. 19/3期の見通し

- 市場環境がより厳しくなり、中国内単結晶・PERCのOEMで稼働・採算の確保を図る
- 2018年の世界導入量は、95-115GWと拡大維持の見通しであることから、PERC技術の高変換優位性で販売価格を確保

《施策》

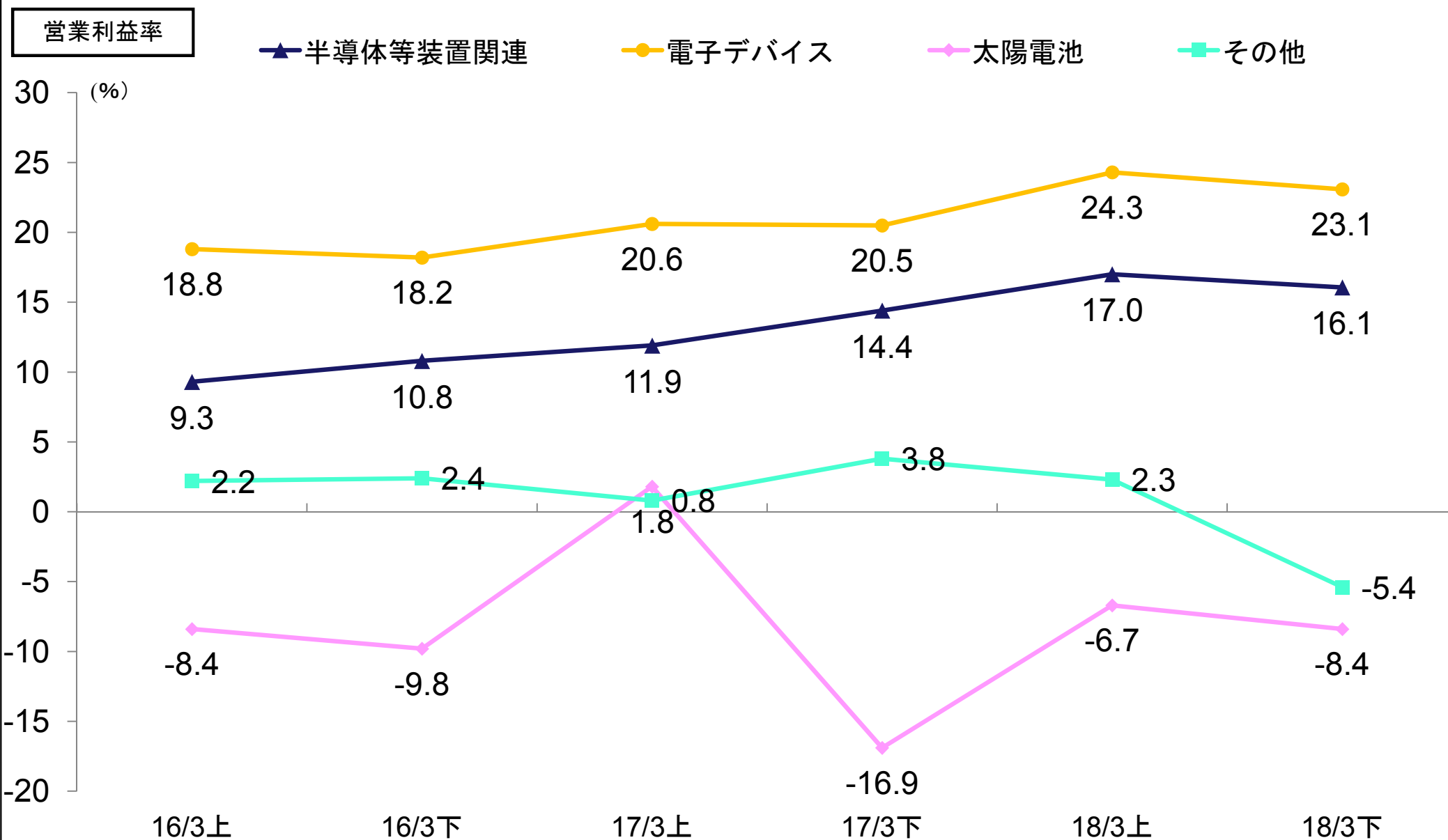
- PERC技術の導入で変換効率向上させ収益改善
- 高変換効率・付加価値品に集中
- ウェーハの品質に加えセル技術で競争力アップ
- 自動化によるコストダウン

商号	株式会社フェローテックホールディングス 英語表記 : Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日
本社	東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5F
市場	JASDAQスタンダード (証券コード:6890)
代表者	代表取締役社長 山村 章
事業内容	グループ会社の経営管理、研究開発業務
資本金	17,607百万円
発行済株式数	37,096,702株(自己株式93,568株を含む)
関連会社	【連結子会社】35社 【持分法適用子会社】6社
従業員	【連結】6,719名 【単体】80名

1980年～	1990年～	2000年～
<p>磁性流体・応用製品 (CPシール・真空シール) の製造・販売を開始</p> <p>真空シール</p> 	<p>92年～:サーモモジュール・モジュール の製造・販売を中国で開始</p> <p>98年～:半導体関連事業向け石英 製品の製造・販売を開始</p> <p>サーモモジュール</p>  <p>石英</p> 	<p>02年～:シリコンウェハー加工・工作機械等の 受託事業を開始(上海工場)</p> <p>05年～:太陽電池関連事業を開始 インゴット・ 結晶製造装置・坩堝の製造・販売</p> <p>08年～:セラミックス製品の製造・開発を開始</p> <p>インゴット</p>  <p>単結晶製造装置</p>  <p>マシナブルセラミックス</p> 

磁性流体技術を核に ～ 当社グループ事業の コアとなる技術 ～	積極的に海外へ進出	新たな収益基盤を確立
	<p>91年～:米国マサチューセッツ州に法人設立</p> <p>92年～:中国杭州に法人設立</p> <p>95年～:中国上海に法人設立</p> <p>97年～:シンガポールに法人設立</p> <p>99年～:フェローフルイディクス社を買収、 北米・欧州への展開を開始</p>	<p>02年～:中国上海工場にてシリコンウェーハ加工・ 工作機械等の受託事業(CMS)を開始</p> <p>部品加工～組立までの一貫した生産技術の 蓄積がCMS事業への進出を実現</p> <p>05年～:中国杭州にて太陽電池関連製品の製造・ 販売を強化</p>

セグメント別営業利益率の推移



M&A・アライアンス・グループ戦略



時期	M&A・アライアンス・グループ戦略	具体的な内容
2017年 4月	持株会社体制へ移行し、社名を変更	株式会社フェローテックホールディングスへ商号を変更
2016年 7月	株式会社アサヒ製作所を子会社化	業務用クリーニング関連機器の大手メーカーを連結子会社化
2015年 7月	株式会社アドマップを子会社化	CVD-SiC製品の製造・販売を手がけるアドマップを連結子会社化
2010年 9月	中国に合併で製造・販売会社設立	角槽及び関連製品の製造・販売のため、現地子会社及びコバレントマテリアル社の三社による合併会社「杭州晶鑫科技有限公司」の設立を合意
2010年 7月	米国IMI社の株式を取得	ピュアシリコン製品の販売を開始
2010年 1月	英国Edwards Vacuum Inc.より事業譲受	同社からTemescal事業部を取得。LEDをはじめとする化合物半導体産業へ積極展開
2008年 7月	住金セラミックス・アンド・クォーツ(株)の株式取得・子会社化・商号変更	住金セラミックス・アンド・クォーツ(株)のセラミックス事業を分社化させ、2008年7月に取得・子会社化した。「フェローテックセラミックス」
2007年 12月	韓国に合併で組立販売会社設立	太陽電池製造装置製造会社を現地企業と合併で「CMCフェローテック」を設立
2007年 4月	韓国に合併で製造会社設立	真空シール製造のためKSMC社と合併で「Ferrotec Korea Co., Ltd.」を設立
2006年 11月	子会社の吸収合併および清算	真空シール製造のフェローテック精密を吸収合併。子会社2社を清算(12月)
2006年 9月	台湾に合併で販売会社を設立	地元資本と合併で、真空シールの販売とメンテナンスを行うフェローテック台湾を設立
2005年 12月	米国LTD Ceramics社と合併会社設立	中国でセラミックス製造のための合併会社を設立
2005年 7月	ロシアNORD社の株式を取得	ペルチェ素子の製造・販売会社を連結子会社化、世界シェアを拡大
2005年 5月	韓国KSM社と事業提携	真空シール、半導体製造半導体等装置関連製品の相互販売提携
2004年 7月	独アプライトフィルムズ社と独占供給契約締結	同社向けに当社真空シールを独占的に提供
2003年 10月	石英製品製造のアリオンテックと業務提携及び資本提携	石英製品の研削加工技術を持つアリオンテック社と技術提携し、中国における石英製品の製造技術を強化
2002年 2月	東芝セラミックス・三井物産と提携しシリコンウェハの受託製造を開始	CMS事業として同社シリコンウェハ製造設備を中国工場に移管、同社向け製造受託

業績比較(18/3期 計画(11/14修正後)と実績)



百万円	2018年3月期 修正計画		2018年3月期 実績			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	41,694	49.1	44,150	48.7	2,456	5.9
真空シール	10,937	12.9	11,761	13.0	824	7.5
石英製品	10,700	12.6	11,523	12.7	823	7.7
セラミックス	8,075	9.5	8,729	9.6	654	8.1
CVD-SiC	3,304	3.9	3,039	3.4	△ 265	△ 8.0
EBガン・LED蒸着装置	3,772	4.4	3,936	4.3	164	4.4
ウェーハ加工	4,906	5.8	5,161	5.7	255	5.2
電 子 デ バ イ ス	12,407	14.6	12,701	14.0	294	2.4
サーモモジュール	11,476	13.5	11,634	12.8	158	1.4
磁性流体・その他	931	1.1	1,068	1.2	137	14.7
太 陽 電 池	18,978	22.3	20,938	23.1	1,960	10.3
石英坩堝	1,645	1.9	1,850	2.0	205	12.5
太陽電池用シリコン	11,755	13.8	13,066	14.4	1,311	11.2
シリコン結晶製造装置	105	0.1	157	0.2	52	49.5
セル・その他	5,473	6.4	5,865	6.5	392	7.2
そ の 他	11,921	14.0	12,807	14.1	886	7.4
合 計	85,000	100.0	90,597	100.0	5,597	6.6
売 上 総 利 益	23,900	28.1	24,915	27.5	1,015	4.2
販 売 管 理 費	15,400	18.1	16,478	18.2	1,078	7.0
営 業 利 益	8,500	10.0	8,437	9.3	△ 63	△ 0.7
経 常 利 益	7,500	8.8	7,157	7.9	△ 343	△ 4.6
当 期 純 利 益	4,400	5.2	2,678	3.0	△ 1,722	△ 39.1

※以降、当期・四半期純利益は親会社に帰属する当期純利益を指す
数値については一部丸め処理を行ったものを記載

業績比較(18/3期上期と下期)



百万円	2018年3月期上期 実績		2018年3月期下期 実績			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	20,617	48.0	23,532	49.4	2,915	14.1
真空シール	5,622	13.1	6,139	12.9	517	9.2
石英製品	5,153	12.0	6,370	13.4	1,217	23.6
セラミックス	4,087	9.5	4,642	9.7	555	13.6
CVD-SiC	1,643	3.8	1,396	2.9	△ 247	△ 15.0
EBガン・LED蒸着装置	1,674	3.9	2,262	4.8	588	35.1
ウェーハ加工	2,438	5.7	2,723	5.7	285	11.7
電 子 デ バ イ ス	6,305	14.7	6,397	13.4	92	1.5
サーモモジュール	5,853	13.6	5,781	12.1	△ 72	△ 1.2
磁性流体・その他	452	1.1	616	1.3	164	36.3
太 陽 電 池	9,972	23.2	10,967	23.0	995	10.0
石英坩堝	811	1.9	1,039	2.2	228	28.1
太陽電池用シリコン	6,078	14.1	6,988	14.7	910	15.0
シリコン結晶製造装置	77	0.2	80	0.2	3	3.9
セル・その他	3,006	7.0	2,859	6.0	△ 147	△ 4.9
そ の 他	6,090	14.2	6,718	14.1	628	10.3
合 計	42,984	100.0	47,613	100.0	4,629	10.8

売 上 総 利 益	12,294	28.6	12,621	26.5	327	2.7
販 売 管 理 費	7,796	18.1	8,682	18.2	886	11.4
営 業 利 益	4,498	10.5	3,939	8.3	△ 559	△ 12.4
経 常 利 益	3,857	9.0	3,301	6.9	△ 556	△ 14.4
四 半 期 純 利 益	2,299	5.3	379	0.8	△ 1,920	△ 83.5

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載

業績比較(17/3期と18/3期)



百万円	2017年3月期 実績		2018年3月期 実績			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	32,243	43.7	44,150	48.7	11,907	36.9
真空シール	8,160	11.0	11,761	13.0	3,601	44.1
石英製品	8,242	11.2	11,523	12.7	3,281	39.8
セラミックス	6,266	8.5	8,729	9.6	2,463	39.3
CVD-SiC	1,905	2.6	3,039	3.4	1,134	59.5
EBガン・LED蒸着装置	3,817	5.2	3,936	4.3	119	3.1
ウェーハ加工	3,854	5.2	5,161	5.7	1,307	33.9
電 子 デ バ イ ス	12,627	17.1	12,701	14.0	74	0.6
サーモジュール	11,747	15.9	11,634	12.8	△ 113	△ 1.0
磁性流体・その他	879	1.2	1,068	1.2	189	21.5
太 陽 電 池	18,773	25.4	20,938	23.1	2,165	11.5
石英坩堝	2,041	2.8	1,850	2.0	△ 191	△ 9.4
太陽電池用シリコン	10,599	14.4	13,066	14.4	2,467	23.3
シリコン結晶製造装置	967	1.3	157	0.2	△ 810	△ 83.8
セル・その他	5,166	7.0	5,865	6.5	699	13.5
そ の 他	10,204	13.8	12,807	14.1	2,603	25.5
合 計	73,847	100.0	90,597	100.0	16,750	22.7

売 上 総 利 益	19,709	26.7	24,915	27.5	5,206	26.4
販 売 管 理 費	14,031	19.0	16,478	18.2	2,447	17.4
営 業 利 益	5,678	7.7	8,437	9.3	2,759	48.6
経 常 利 益	5,675	7.7	7,157	7.9	1,482	26.1
当 期 純 利 益	3,256	4.4	2,678	3.0	△ 578	△ 17.8
設 備 投 資 額	7,322	-	11,087	-	3,765	51.4
減 価 償 却 費	3,593	-	4,188	-	595	16.6

※設備投資は、前期設備未払金を考慮したCFベースの数値です。

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載

業績比較(18/3期 実績と19/3期 計画値)



百万円	2018年3月期 実績		2019年3月期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	44,150	48.7	58,710	59.9	14,561	33.0
真空シール	11,761	13.0	15,000	15.3	3,239	27.5
石英製品	11,523	12.7	13,640	13.9	2,118	18.4
セラミックス	8,729	9.6	11,500	11.7	2,771	31.7
CVD-SiC	3,039	3.4	3,000	3.1	△ 40	△ 1.3
EBガン・LED蒸着装置	3,936	4.3	4,270	4.4	334	8.5
ウェーハ加工	5,161	5.7	7,500	7.7	2,339	45.3
装置部品洗浄	-	-	3,800	3.9	3,800	-
電 子 デ バ イ ス	12,701	14.0	12,930	13.2	230	1.8
サーモモジュール	11,634	12.8	11,880	12.1	246	2.1
磁性流体・その他	1,068	1.2	1,050	1.1	△ 17	△ 1.6
太 陽 電 池	20,938	23.1	16,207	16.5	△ 4,731	△ 22.6
石英坩堝	1,850	2.0	2,000	2.0	150	8.1
太陽電池用シリコン	13,066	14.4	8,317	8.5	△ 4,749	△ 36.3
シリコン結晶製造装置	157	0.2	120	0.1	△ 37	△ 23.6
セル・その他	5,865	6.5	5,770	5.9	△ 95	△ 1.6
そ の 他	12,807	14.1	10,153	10.4	△ 2,655	△ 20.7
合 計	90,597	100.0	98,000	100.0	7,403	8.2
売 上 総 利 益	24,915	27.5	27,900	28.5	2,985	12.0
販 売 管 理 費	16,477	18.2	18,100	18.5	1,622	9.8
営 業 利 益	8,437	9.3	9,800	10.0	1,363	16.2
経 常 利 益	7,157	7.9	8,500	8.7	1,343	18.8
当 期 純 利 益	2,678	3.0	5,300	5.4	2,622	97.9
設 備 投 資 額	12,300	-	40,000	-	27,700	-
減 価 償 却 費	4,188	-	5,000	-	812	-

※設備投資は、前期設備未払金を考慮したCFベースの数値です。

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載

業績比較(19/3期 計画値 上期と下期)



百万円	2019年3月期上期 計画		2019年3月期下期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	28,460	61.9	30,250	58.2	1,790	6.3
真空シール	7,800	17.0	7,200	13.8	△ 600	△ 7.7
石英製品	6,830	14.8	6,811	13.1	△ 19	△ 0.3
セラミックス	5,550	12.1	5,950	11.4	400	7.2
CVD-SiC	1,450	3.2	1,549	3.0	99	6.8
EBガン・LED蒸着装置	2,070	4.5	2,200	4.2	130	6.3
ウェーハ加工	2,960	6.4	4,540	8.7	1,580	53.4
装置部品洗浄	1,800	3.9	2,000	3.8	200	11.1
電 子 デ バ イ ス	5,860	12.7	7,071	13.6	1,211	20.7
サーモジュール	5,350	11.6	6,530	12.6	1,180	22.1
磁性流体・その他	510	1.1	541	1.0	31	6.1
太 陽 電 池	6,420	14.0	9,787	18.8	3,367	52.5
石英坩堝	900	2.0	1,100	2.1	200	22.2
太陽電池用シリコン	2,800	6.1	5,517	10.6	2,717	97.0
シリコン結晶製造装置	119.8	0.3	0.2	0.0	△ 120	△ 99.8
セル・その他	2,600	5.7	3,170	6.1	570	21.9
そ の 他	5,261	11.4	4,891	9.4	△ 369	△ 7.0
合 計	46,000	100.0	52,000	100.0	6,000	13.0
売 上 総 利 益	13,079	28.4	14,821	28.5	1,742	13.3
販 売 管 理 費	8,479	18.4	9,621	18.5	1,142	13.5
営 業 利 益	4,600	10.0	5,200	10.0	600	13.0
経 常 利 益	3,900	8.5	4,600	8.8	700	17.9
四 半 期 純 利 益	2,400	5.2	2,900	5.6	500	20.8

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載